

Круглый Держатель Для Пластин Из Ptfе 6 Дюймов, Устойчивый К Кислотам И Щелочам, Корзина Для Очистки Полупроводников, Настраиваемая

Артикул: PL-CP207



введение

Высококачественные 6-дюймовые круглые держатели для пластин из PTFE, разработанные для очистки полупроводников. Отличная устойчивость к кислотам и щелочам для травления пиранией и плавиковой кислотой. Прецизионно обработанные, полностью настраиваемые корзины обеспечивают безопасную обработку подложек в ходе требовательных влажных химических процессов, иммерсионных ванн и ультразвукового ополаскивания.

[Узнать больше](#)

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Процесс очистки RCA	Используется для удаления органических остатков, тонких оксидных слоев и ионного загрязнения с кремниевых пластин с использованием растворов SC-1 и SC-2.	Высокая термическая и химическая стойкость предотвращает деградацию держателя во время погружения в нагретую ванну.
Травление пиранией	Обработка пластин в смеси серной кислоты и перекиси водорода для удаления тяжелых органических веществ.	Исключительная устойчивость к агрессивным окислительным средам обеспечивает длительный срок службы оборудования.
Погружение в плавиковую (HF) кислоту	Удаление жертвенных оксидных слоев или естественных оксидов с поверхностей кремния в различных концентрациях HF.	Чистота материала предотвращает попадание ионов металлов в чувствительную среду травления.
Ополаскивание после CMP	Транспортировка пластин через циклы очистки после химико-механической полировки для удаления частиц суспензии.	Гладкие, антипригарные поверхности предотвращают захват частиц и способствуют эффективной ультразвуковой очистке.
Производство солнечных элементов	Обработка 6-дюймовых монокристаллических или поликристаллических кремниевых пластин на этапах текстурирования и фосфорной диффузии.	Прочная конструкция поддерживает высокую производительность в требовательных промышленных производственных линиях.
Фотолитография	Поддержка подложек во время проявления и удаления фоторезиста с использованием растворителей и специализированных стрипперов.	Универсальная совместимость с растворителями предотвращает набухание или размягчение рамы держателя.
Ультразвуковая очистка	Транспортировка деликатных компонентов в ультразвуковых или мегазвуковых ваннах для высокоточного удаления загрязнений.	Конструкционная жесткость позволяет эффективно передавать акустическую энергию на поверхности пластин.
Травление сложных полупроводников	Обработка пластин GaAs, InP или SiC в специализированных химических смесях для производства оптоэлектронных устройств.	Настраиваемая геометрия прорезей подходит для пластин различной толщины и хрупких материалов подложек.

Параметр	Детали спецификации для PL-CP207
Идентификатор модели	PL-CP207

Применение	Описание	Ключевое преимущество
Параметр	Детали спецификации для PL-CP207	
Материал конструкции	Высокочистый первичный PTFE (доступны опции из PFA по запросу)	
Совместимость с размером пластин	6 дюймов / 150 мм в диаметре	
Конфигурация геометрии	Круглая очистная корзина / тип "цветочной корзины"	
Химическая совместимость	Универсальная стойкость (кислоты, основания, растворители, окислители)	
Температурный допуск	Подходит для криогенной и высокотемпературной обработки	
Возможность настройки	Полностью настраиваемые размеры, количество прорезей и конфигурации ручек	
Отделка поверхности	Прецизионно обработанная, сверхгладкая, непористая	
Емкость партии	Разрабатывается индивидуально в соответствии с конкретными требованиями клиента по количеству пластин	
Метод производства	Индивидуальное фрезерование с ЧПУ / Изготовление на заказ	